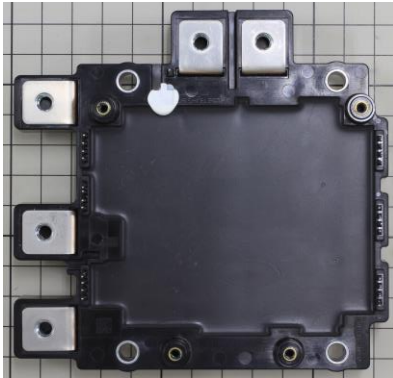
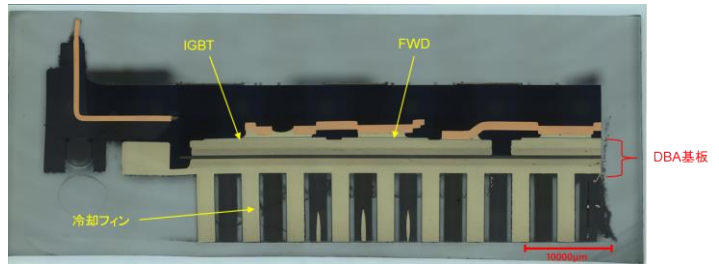


日産Note e-Powerインバーター搭載 三菱電機製 IGBTモジュール 構造解析レポート



搭載パワーモジュール外観



搭載INV制御基板

概要

- ・前世代に搭載のInfineon社製のIGBTモジュール(EDT2:片面冷却)が搭載であったが、第2世代のユニットは、三菱電機製モジュール(片面冷却)を採用。
- ※駆動基板はモジュールとセットで2ユニット搭載
- ・搭載パワーモジュール+制御基板の容量、重量はInfineonと比較して約半分出力はほぼ同等となっており、パワーモジュールの小型化がユニットの小型化に大きく寄与している。
- ・本レポートでは小型化のポイントとなる放熱の点に注目し、モジュールの積層構造、チップレイアウトなどレポートにしています。

製品特長

- ・日産Note_e-Power(HEV) 2020年12月発売
- ・三菱電機製:CT700CJ1A080-N 650V
- ・出力:116ps、最大トルク:280Nm(三菱電機製 パワーモジュール(2基)搭載)

解析内容(予定)

- ・素子レイアウト
- ・モジュール断面構造解析、各層厚、各層、フィラーの組成分析
- ・搭載チップ表面写真、サイズ

レポート価格

価格: 50万円(税別)

目次

		Page
1. デバイスサマリー	...	3
1-1. 解析結果まとめ	...	4
2. モジュール構造解析		
2-1. 外観観察	...	7
2-2. モジュール内部観察	...	13
2-3. 搭載チップ観察	...	19
2-4. モジュール断面観察	...	20

